



kingston.com/epop

ePoP

ePoP - 웨어러블용 임베디드 패키지 온 패키지 (Embedded Package-on-Package, ePoP) 메모리

Kingston의 ePoP는 내장형 멀티미디어 카드(Embedded MultiMedia Card, eMMC) 스토리지와 저전력 이중 데이터 전송률(Low-Power Double Data Rate, LPDDR) DRAM을 하나의 패키지 온 패키지(Package-on-Package, PoP) 솔루션으로 결합한 고도로 통합된 JEDEC 표준 컴포넌트를 제공합니다. ePoP는 호환 가능한 호스트 단일 칩 체제(System-on-a-Chip, SoC)의 상단에 직접 장착되어 인쇄 회로 기판(PCB) 공간을 효율적으로 절약하며, 최적의 성능을 보장합니다. ePoP는 웨어러블과 같이 공간 제한이 심한 응용 분야에 이상적인 솔루션입니다.

주요 이점

- ePoP는 호스트 SoC의 상단에 직접 장착되기 때문에, 웨어러블을 비롯한 소형 폼 팩터 응용 분야에 적용할 수 있는 이상적인 솔루션을 제공합니다.
- 저전력 DRAM과 최적화된 스토리지 펌웨어가 전력 소비를 낮추는 동시에 배터리로 작동하는 웨어러블 응용 분야에 필요한 높은 성능을 제공합니다.
- 시스템 설계를 단순화하고 시장 출시 시간을 단축하며 적격성 평가 주기를 줄입니다.
- 성능, 전력 및 수명에 대한 응용 분야 요구 사항에 가장 잘 부합하도록 다중 펌웨어 구성을 이용할 수 있습니다.

시장 부문



IoT



웨어러블



증강현실(AR) / 가상현실(VR) 기기

EPoP 부품 번호 및 사양

LPDDR3 기반 ePoP

부품 번호	용량		표준		패키지	FBGA	작동 온도
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EP04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	10x10x0.8	136	-25°C ~ +85°C
04EP08-N3GM627	4	8	5.0	LPDDR3	10x10x0.85	136	-25°C ~ +85°C
08EP08-N3GTC32*	8	8	5.1	LPDDR3	10x10x0.85	136	-25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32	32	8	5.1	LPDDR3	10x10x0.85	136	-25°C ~ +85°C

LPDDR4x 기반 ePoP

부품 번호	용량		표준		패키지	FBGA	작동 온도
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
08EP08-M4ETC32*	8	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
08CP08-M4ETC32*	8	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.85	144	-25°C ~ +85°C
16EP08-M4ETC32	16	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
32EP08-M4ETC32	32	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
16EP16-M4FTC32	16	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
32EP16-M4FTC32	32	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
32CP16-M4FTC32	32	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.85	144	-25°C ~ +85°C

*보다 높은 내구성을 위해 pSLC 모드 사용

